

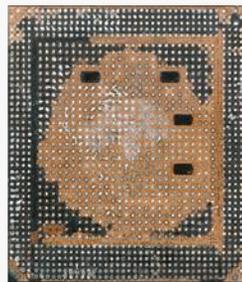
iPhone7搭載Apple A10プロセッサのパッケージ解析レポート

株式会社エルテックは、Apple製A10プロセッサのパッケージレポートをリリースしました。A10プロセッサは、TSMCのInFO技術を採用し、パッケージ厚を20%減少させています。

エルテックは、InFO技術の最大の特徴であるRDL(Re-Distribution Layer)各層のレイアウトパターンの2値化に成功しました。本レポートは、断面構造解析とともに、RDLの平面レイアウト解析を行い、各層がいかに関数なレイアウトを行っているか、強度を持たせている工夫、信号をパワー系配線をどのように分けているか等が明確になっています。



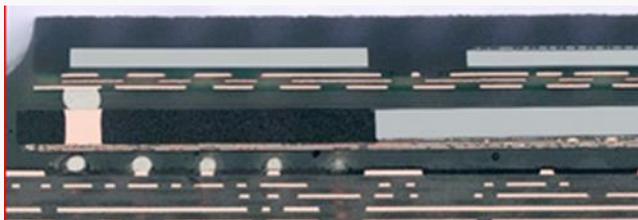
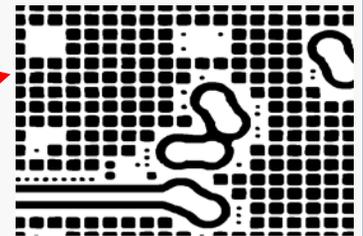
Package(Top)



Package(Bottom)



Digitized RDL3



Cross section (Partial)

レポートは、断面構造解析(42ページ)、RDL平面レイアウト解析(35ページ)、RDL各層の2値化データが含まれています。また、オプションとして、RDLのGerber,DXF,PADS(ASCII)または、ODB++の各種フォーマットでの提供も可能です。

販売価格(税別) ￥500,000

オプション価格(税別) ￥100,000(Gerber,DXF,PADS(ASCII),ODB++)

(注)オプションのみの販売は行っていません

16G-0011-1&2

Table of Contents

16G-0011-1(断面構造解析)		
		Page
解析結果まとめ	...	3
1. 製品概要	...	7
2. 外観観察	...	9
3. X-ray観察	...	10
4. 断面加工箇所	...	11
5. 断面観察	...	12
6. 断面観察+厚み計測(Bottom PKG)	...	13
7. 断面観察+厚み計測(RDL)	...	14
8. 断面観察+厚み計測(Si-Capacitor)	...	18
9. 断面観察+厚み計測(Mold resin)	...	26
10. 断面観察+厚み計測(2 nd Underfill)	...	29
11. 断面観察+厚み計測(Through InFO via)	...	30
12. 断面観察+厚み計測(1 st Underfill)	...	33
13. 断面観察+厚み計測(Top PKG)	...	34
14. 断面観察+厚み計測(Memory die)	...	36
15. 断面観察+厚み計測(ソルダーレジスト)	...	38
16. 断面観察+厚み計測(PCB)	...	40
17. 断面観察+厚み計測(A10PKG~PCB)	...	42
18. 断面観察+厚み計測(全体)	...	43
16G-0011-2(RDL部平面レイアウト解析)		
		Page
解析結果まとめ	...	3
1. 各層の概要	...	4
2. 裏面ボールと電源、GNDの接続について	...	7
3. RDK各層のLine,Space測定	...	30

16G-0011-1&2

